

AUTUMN
2006

株・主・通・信

SCREEN NOW vol. 60

● 特集 ● 新たな成長をけん引する半導体製造装置事業



目次

ダイアログ…1

なるほど用語解説…5

第1四半期決算レポート…7

トピックス…11

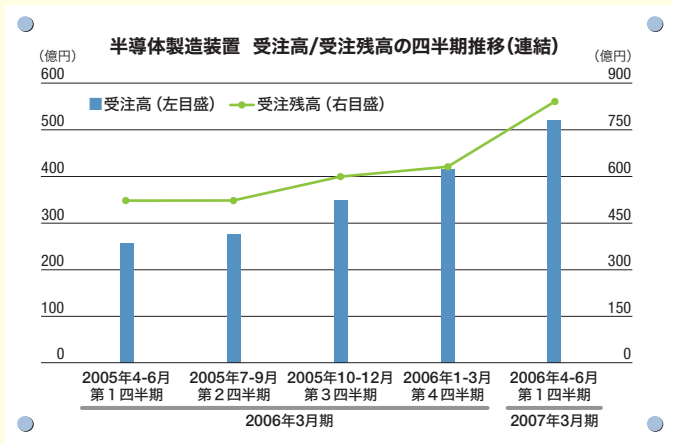
スクリーンを探そう…14

大日本スクリーン製造株式会社

— 新たな成長をけん引する 半導体製造装置事業 —

半導体の用途拡大とともに、市場が拡大している半導体製造装置。高い技術力が求められる中で、当社の競争力の強さと今後の戦略を、半導体機器カンパニー社長の末武隆成が語ります。

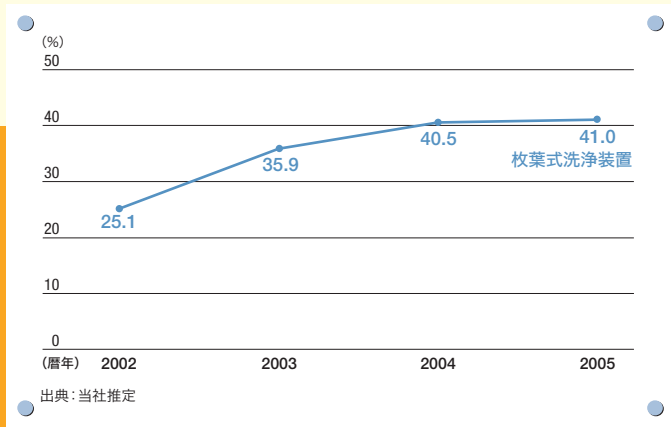
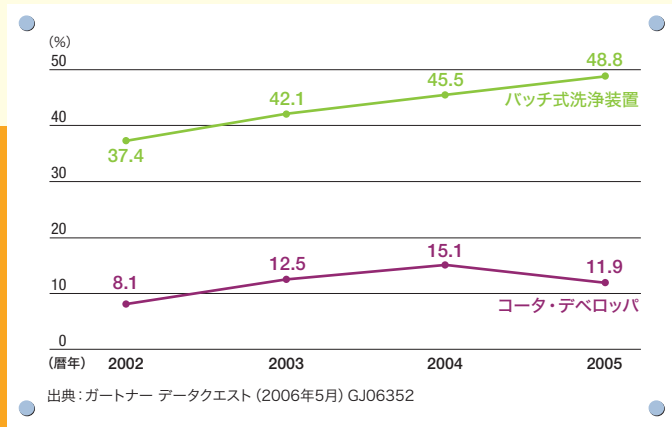
取締役副会長
半導体機器カンパニー社長
末武 隆成



— 新たな成長に向けて2007年3月期がスタート
しましたが、受注状況についてお話しください。

当社の半導体製造装置事業の受注高は、前第1四半期(2005年4月1日～6月30日)から順調に増加してきており、当第1四半期(2006年4月1日～6月30日)は四半期ベースで過去最高の受注額を獲得しました。お客さま別では、携帯音楽プレーヤーや携帯電話用フラッシュメモリーを中心としたメモリーメーカーや、ファンドリーからの受注がけん引しました。製品別では各製品群とも堅調でしたが、特に複数のウエハーを一括して処理するバッチ式洗浄装置の受注が増加しました。

半導体製造装置 世界市場シェアの推移



これは、引き続き高い需要が見込まれるメモリーは基本的に大量生産されることから、1時間当たりの処理枚数が多いバッチ式洗浄装置の需要が増加したためです。また、洗浄装置において、当社が高い市場シェアを誇り、豊富なノウハウと実績を持っていることも、受注拡大に寄与しています。バッチ式洗浄装置の製品としては、当社の「FC-3000」が300ミリウエハー対応の洗浄装置としてグローバルスタンダードになっていますし、その後継機である「FC-3100」も順調に伸びています。一方、半導体の用途拡大に伴い、少量多品種生産に適している枚葉式洗浄装置についても、300ミリウエハー対応の洗浄装置において

着実にシェアが拡大していると考えています。また、地域別では、2006年3月期の第4四半期に比べて、国内に加え、台湾、韓国を中心としたアジアや米国での受注が増加しました。

— 活発な受注に対応するための生産体制はどうなっていますか。

半導体製造装置の需要増加に対応できる生産体制の構築が急務となっていますが、当社は現在、ウエハー洗浄装置の生産増強に向けて彦根地区事業所内に新工場「Fab.FC-2 (ファブ・エフシーツー)」を建設しており、今年の11月から操業



新工場「Fab.FC-2」の完成イメージ

を開始する予定です。「Fab.FC-2」は、既存の工場「Fab.FC-1（ファブ・エフシーワン）」に隣接して建設し、施設の一部を共有するだけでなく、コンセプトや基本設計も踏襲しているため、極めて短い工期で完工できます。また、「Fab.FC-1」とほぼ同程度の生産能力の増強となり、堅調な状況が続くと見込まれる半導体メーカーへの、長期にわたる安定供給が可能となります。当初は受注が活発なバッチ式洗浄装置の生産が中心となりますが、将来的には枚葉式洗浄装置の需要増加にも対応していきます。さらに、将来予想される450ミリウエハー対応洗浄装置の生産にも対応できるなど、次世代半導体への対応も視野に入れた設備となっています。

—コータ・デベロッパ事業の再構築について お聞かせください。

2005年(暦年)に12%弱まで下がったシェアを拡大し、事業を再構築するために、当社は2006年7月3日、コータ・デベロッパ事業部門を分社化して(株)SOKUDOを設立しました。そして、(株)SOKUDOは7月20日に、半導体製造装置メーカーの最大手である米国Applied Materials(アプライド マテリアルズ)社を割当先とする第三者割当増資を行い、合弁事業を開始しました。これによって、当社が保有するコータ・デベロッパに関する高い技術力とアプライド マテリアルズ社が持つ総合力を融合させ、製品競争力の向上を図っていきます。なお、製造面では、当社が受託生産することにより高品質な製品をタイムリーに提供できる体制を維持し、また、国内と米国に拠点を設けて、開発、製造、販売、保守サービスなど、ワールドワイドなお客さまのニーズに対応していきます。

株式会社SOKUDOの概要

SOKUDO

本社所在地 ● 京都市

設立日 ● 2006年7月3日

資本金 ● 83億1,748万円(2006年7月20日現在)

代表者 ● 代表取締役社長 末武隆成

主な業務 ● 半導体関連コータ・デベロッパに関する開発、製造、販売、保守事業

ホームページアドレス ● www.sokudospeed.com



(株)SOKUDO本社

—今後の市場動向と事業戦略について

お教えください。

半導体メーカーの設備投資については、多少の調整はあるものの、総じて堅調に推移すると思われます。実際、今年7月に発表された(社)日本半導体製造装置協会の予測では、日本製半導体製造装置のうち、当社が関連するプロセス用処理装置の2006年度販売高は、前年度比13.0%増加の1兆743億円とされており、2007年度も堅調な推移が期待されています。

そうした中、当社は主力の洗浄装置のシェア拡大に注力していきます。バッチ式洗浄装置では、2005年7月に販売を開始した「FC-3100」の拡販を図ります。「FC-3100」は、リードタイムや製品の立ち上げ期間の短縮を実現するほか、1時間当たりのウエハー処理枚数も「FC-3000」より多くなっており、お客さまの生産性向上に貢献する装置です。また、枚葉式洗浄装置では、超微細パターンのウエハー洗浄を可能にする、当社独自の新技术「Nanospray2(ナノスプレー・ツー)」をオプションで搭載した新製品を市場投入していきます。



新ウエハー洗浄技術「Nanospray2」

—中長期的な戦略についてお話しください。

半導体業界では回路の微細化が進んでおり、線幅65ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)だけでなく、45ナノメートル以降の次世代半導体に対応するプロセス技術の確立が急務となっています。回路の微細化が進展するとともに、配線材料がアルミから銅に替わってきているなど、半導体製造の材料も多様化しています。当社はそうした変化に適応し、安定した製造装置をいち早く開発して市場に投入していくため、研究開発に積極的に取り組んでいきます。また、次世代の半導体製造プロセスに必要なフラッシュランプアニールをはじめとした新しい装置群の販売拡大にも努めていきます。

用語解説

メモリー: 半導体の一種で、データを記憶する。

フラッシュメモリー:

メモリーの一種で、データの消去・書き込みを自由に行うことができ、電源を切っても内容を保存し続ける。

ファクトリー: 半導体の受託生産を行う企業。

リードタイム: 生産(設計を含む)を開始してから出荷するまでに要する日数。

フラッシュランプアニール:

カメラのフラッシュランプに使用される光源を用いて急速にウエハー表面を加熱する装置。

バッチ式洗浄装置と枚葉式洗浄装置

当社は、株主の皆さまとのより良いコミュニケーションを図るため、「SCREEN NOW」(株主通信)の送付に際しましてアンケートはがきを同封させていただいております。

アンケートを通じてお寄せいただきましたご質問にお答えするべく、今回は洗浄装置の役割と種類について、以下ご説明申し上げます。

半導体ウエハー洗浄装置の役割

半導体の製造工程において、ウエハー洗浄装置はとても重要な役割を担っています。なぜならウエハー上にゴミや汚れが付着していると、半導体の性能や信頼性が損なわれたり、半導体メーカーにとって重要な課題である歩留まり(良品率)が低下したりするからです。そのため多くの主要工程の間には洗浄工程があり、パーティクルと呼ばれる0.1マイクロメートル(1マイクロメートルは100万分の1メートル)から数マイクロメートル

のゴミや、工場内で使用される薬液を要因とする金属や有機物、人の汗に含まれる油脂などの汚染物質を取り除くことが必要です。

回路の微細化の進展に伴い、より高い清浄度が求められる中、ウエハー洗浄装置の役割は、ますます高まっています。

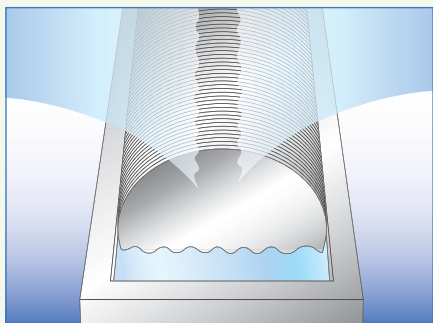
バッチ式洗浄装置と枚葉式洗浄装置の違い

ウエハー洗浄装置は二つに大別されます。一つは「バッチ式」と呼ばれ、複数のウエハーを一度に薬液などに浸して洗浄する方法です。もう一つは「枚葉式」

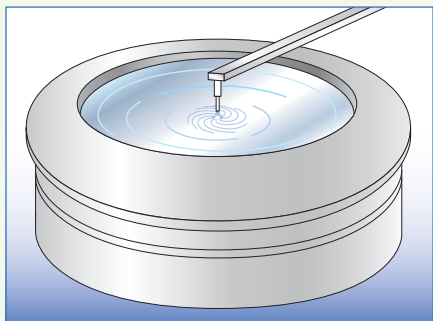
と呼ばれ、一枚ずつウエハーを回転させながら、薬液やブラシなどを用いて洗浄する方法です。一般にバッチ式はスループット(生産効率)が高いため大量生産に向いており、枚葉式は少量多品種生産に向いています。また、バッチ式は、ウエハー全体を液体に浸すため、片面のみといった部分洗浄ができないのに対して、枚葉式は、表面は清浄だが裏面のみ汚れている場合に裏面だけ洗うといった、部分洗浄が可能です。

実際の半導体工場では、コストと目的に合わせて両者の使い分けがなされています。大量に処理しなければならない

い工程で、全体洗浄が可能であるなら、バッチ式洗浄装置を使用し、スルーボットは多少落ちてでも部分洗浄が必要な工程では、枚葉式洗浄装置を使用しています。



バッチ式洗浄の様子



枚葉式洗浄の様子

拡大する枚葉式洗浄装置市場

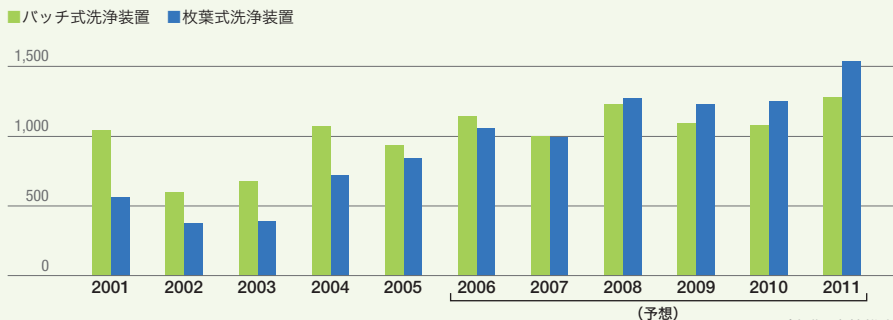
既述のとおり、バッチ式洗浄装置と枚葉式洗浄装置は工場内で並存していますが、今後は枚葉式の市場が伸びていくと予測されています。その背景としては二つの理由が挙げられます。一つは、回路の微細化です。これは、回路の超微細化によって、より細かいパーティクルの除去が必要となるため、ウエハーを一枚ずつ丁寧に洗浄することが必要になってくるためです。もう一つは、半導体

の配線材料がアルミニウムから銅に切り替わってきているためです。銅は、アルミニウムよりウエハーに染み込みやすく、ウエハーの裏面など不要な部分に付着した場合、半導体の性能を低下させるため、確実に除去しなければなりません。そのため、裏面や側面だけを洗浄できる枚葉式洗浄装置のニーズが高まっているのです。

一方、バッチ式洗浄装置には生産効率が高いという利点がありますので、今後もコストと目的に合わせて使い分けがなされ、両装置は併用されていくと考えます。

(百万米ドル)

半導体ウエハー洗浄装置市場の推移



(出典：当社推定)

第1四半期決算レポート

2006年8月10日に発表しました2007年3月期第1四半期(2006年4月1日～6月30日)の財務・業績の概況(連結)につきまして、以下のとおりご報告します。また同時に当期の業績予想の修正も発表しました。

経営成績(連結)

当第1四半期における売上高は、701億2百万円と前年同期に比べて186億8百万円(36.1%)増加し、営業利益は84億1千3百万円と前年同期に比べて40億3千3百万円(92.1%)増加しました。営業外損益では、持分法による投資損失が増加したことや前年同期の為替差益が為替差損に転じたことなどから営業外費用が増加しました。以上の結果、経常利益は前年同期に比べて32億9千万円(75.9%)増加し、76億2千7百万円となりましたが、四半期純利益は親会社における税金費用の発生などから47億9千6百万円と前年同期に比べて15億3千6百万円(47.1%)の増加となりました。

事業別セグメントの業績は以下のとおりです。

電子工業用機器事業におきましては、薄型テレビや携帯音楽プレーヤーなどを中心としたデジタル家電の好調な需要を背景に、半導体メーカー、液晶パネルメーカーの積極的な設備投資が続きました。このような環境の下、当社の半導体製造装置は枚葉式洗浄装置が前年同期に比べて売上を大きく伸ばし、バッチ式洗浄装置、コータ・デベロッパも堅調に推移しました。FPD製造装置は液晶用ガラス基板の大型化が進み、第7世代ガラス基板対応のコータ・デベロッパが韓国、台湾向けに好調に推移しました。以上の結果、当セグメントの売上高は559億4千1百万円と前年同期に比べて173億8千1百万円(45.1%)増加し、営業利益は83億5千6百万円と前年同期に比べて43億9千3百万円(110.9%)増加しました。

画像情報処理機器事業では、国内の売上は前年同期に比べて減少し

ましたが、海外では欧州を中心にCTP(Computer to Plate)関連製品の売上が堅調に推移し、2005年6月に買収した英国のインカ・デジタル・プリンターズ社の売上も寄与しました。その結果、当セグメントの売上高は138億2千1百万円と前年同期に比べて10億9千2百万円(8.6%)増加しましたが、製品単価の下落や販管費の増加などにより1億2千4百万円の営業損失(前年同期に比べて5億7百万円の悪化)となりました。

財政状態(連結)

当第1四半期末の総資産残高は、保有株式の時価の下落から投資有価証券が減少しましたが、受注残の増加に伴う棚卸資産の増加、現金及び預金の増加、売上の増加に伴う売上債権の増加などにより、前期末に比べて160億8千3百万円(6.0%)増加し、2,863億5千7百万円となりました。純資産から少数株主持分を除いた自己資本は1,254億3千9百万円となり、自己資本比率は43.8%となりました。

キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、受注残、売上の増加に伴う棚卸資産や売上債権などの運転資本の増加や法人税等の支払などが税金等調整前四半期純利益を上回ったため、7億4千2百万円の支出(前年同期は29億9千4百万円の収入)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより11億9千7百万円の支出(前年同期は62億円の支出)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、社債の償還、配当金の支払などの支出がありましたが、短期借入による調達を行い、99億7千9百万円の収入(前年同期は66億9千万円の収入)となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は前期末残高に比べて80億6千5百万円増加し、353億1千万円となりました。

業績予想の修正

2007年3月期の中間期(2006年4月1日～2006年9月30日)の業績予想につきましては、半導体製造装置の売上高が受注の増加により好調に推移すると見込まれることから、売上高、利益ともに2006年5月15日に公表しました業績予想を下記のとおり修正し、2006年8月10日に発表しました。

通期(2006年4月1日～2007年3月31日)の業績予想につきましては、半導体製造装置は下半期も好調に推移すると見込んでおりますが、FPD製造装置の売上高が液晶パネルメーカーの設備投資の延期により前回予想を下回る見通しとなったことから、連結業績および単独売上高、経常利益は2006年5月15日発表の予想から変更していません。

なお、単独におきまして、第1四半期で子会社株式評価損約16億円を特別損失として計上いたしました。

■連結業績予想

		売上高	経常利益	当期純利益
中間期	今回予想(2006年8月10日発表)	1,395億円	102億円	71億円
	前回予想(2006年5月15日発表)	1,290億円	71億円	52億円
通期	今回予想(2006年5月15日発表)より変更していません。	2,800億円	190億円	125億円

■単独業績予想

		売上高	経常利益	当期純利益
中間期	今回予想(2006年8月10日発表)	1,200億円	91億円	54億円
	前回予想(2006年5月15日発表)	1,098億円	64億円	53億円
通期	今回予想(2006年8月10日発表)	2,400億円	161億円	100億円
	前回予想(2006年5月15日発表)	2,400億円	161億円	116億円

※上記の予想は、2006年8月10日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

連結貸借対照表 (単位:百万円未満切捨)

科 目	第1四半期末		2006年3月期末
	2006年 6月30日現在	2005年 6月30日現在	2006年 3月31日現在
(資産の部)			
流動資産	202,332	172,140	181,112
現金及び預金	35,483	36,501	27,403
受取手形及び売掛金	90,416	69,174	86,174
有価証券	20	—	20
棚卸資産	68,362	58,583	59,089
繰延税金資産	4,386	3,994	5,271
その他	4,761	5,093	4,128
貸倒引当金	△1,097	△1,207	△976
固定資産	84,024	83,145	89,161
有形固定資産	36,470	34,249	36,096
建物及び構築物	48,331	50,967	48,509
機械装置及び運搬具	26,764	34,335	24,487
土地	9,729	9,555	9,727
建設仮勘定	1,159	887	1,778
その他	8,872	8,993	8,793
減価償却累計額	△58,386	△70,489	△57,200
無形固定資産	4,607	5,435	4,860
のれん	4,017	—	—
連結調整勘定	—	4,909	4,263
その他	589	526	596
投資その他の資産	42,946	43,460	48,205
投資有価証券	38,371	33,888	44,137
長期貸付金	135	209	145
繰延税金資産	713	5,946	364
その他	4,092	3,671	4,024
貸倒引当金	△367	△254	△466
資産合計	286,357	255,285	270,273

連結貸借対照表 (単位:百万円未満切捨)

科 目	第1四半期末		2006年3月期末
	2006年 6月30日現在	2005年 6月30日現在	2006年 3月31日現在
(負債の部)			
流動負債	126,010	102,305	106,134
支払手形及び買掛金	65,590	46,402	55,787
短期借入金	25,516	25,734	10,891
一年以内返済予定の長期借入金	3,941	4,832	3,931
一年以内償還予定の社債	7,000	4,000	8,000
一年以内償還予定の新株予約権付社債	73	—	91
未払法人税等	3,023	1,277	2,755
設備関係支払手形	1,684	1,186	1,715
製品保証引当金	2,619	1,779	2,158
ブラウ管管用マスク事業整理損失引当金	—	1,769	—
その他	16,561	15,322	20,803
固定負債	34,257	48,667	37,082
社債	—	7,000	—
新株予約権付社債	15,000	16,592	15,000
長期借入金	8,561	12,177	9,674
退職給付引当金	9,460	11,518	10,095
役員退職引当金	132	114	117
債務保証損失引当金	154	281	154
土壤浄化対策引当金	556	556	556
繰延税金負債	—	—	1,049
その他	391	427	434
負債合計	160,267	150,972	143,216

科 目	第1四半期末		2006年3月期末
	2006年 6月30日現在	2005年 6月30日現在	2006年 3月31日現在
少数株主持分	—	555	629
(資本の部)			
資本金	—	53,248	53,998
資本剰余金	—	29,380	30,131
利益剰余金	—	20,559	32,536
その他有価証券評価差額金	—	7,066	15,038
為替換算調整勘定	—	△5,651	△4,372
自己株式	—	△845	△904
資本合計	—	103,758	126,427
負債、少数株主持分及び資本合計	—	255,285	270,273
(純資産の部)			
株主資本	118,073	—	—
資本金	54,007	—	—
資本剰余金	30,140	—	—
利益剰余金	34,841	—	—
自己株式	△917	—	—
評価・換算差額等	7,366	—	—
その他有価証券評価差額金	11,836	—	—
繰延ヘッジ損益	△124	—	—
為替換算調整勘定	△4,346	—	—
少数株主持分	650	—	—
純資産合計	126,089	—	—
負債、純資産合計	286,357	—	—

連結損益計算書 (単位:百万円未満切捨)

科 目	第1四半期		2006年3月期
	2006年4月1日から 2006年6月30日まで	2005年4月1日から 2005年6月30日まで	2005年4月1日から 2006年3月31日まで
売上高	70,102	51,493	246,533
売上原価	46,358	34,469	173,636
割賦販売調整前売上総利益	23,744	17,024	72,897
割賦販売調整高	1	2	7
売上総利益	23,745	17,027	72,905
販売費及び一般管理費	15,332	12,647	54,338
営業利益	8,413	4,380	18,567
営業外収益	554	570	1,850
営業外費用	1,340	614	3,138
経常利益	7,627	4,336	17,279
特別利益	863	27	3,983
特別損失	0	74	93
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,489	4,289	21,169
法人税、住民税及び事業税	2,240	411	3,447
法人税等調整額	1,423	604	2,494
少数株主利益又は少数株主損失(△)	29	13	△8
四半期(当期)純利益	4,796	3,259	15,236

連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円未満切捨)

科 目	第1四半期	2006年3月期
	2006年4月1日から 2006年6月30日まで	2005年4月1日から 2006年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	△742	14,906
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,489	21,169
減価償却費	920	3,822
売上債権の増加額	△4,068	△454
棚卸資産の増加額	△9,287	△4,612
仕入債務の増加額	9,693	985
法人税等の支払額	△1,944	△3,338
その他	△4,545	△2,665
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,197	△7,482
有形固定資産の取得による支出	△2,001	△4,653
投資有価証券の売却による収入	639	4,140
新規連結子会社の取得による支出	—	△5,738
その他	163	△1,231
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,979	△13,441
短期借入金の純増減額(減少:△)	14,627	△16,581
長期借入による収入	—	11,330
長期借入金の返済による支出	△1,102	△3,866
社債の償還による支出	△1,000	△3,000
配当金の支払額	△2,524	△1,820
その他	△20	497
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	616
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	8,065	△5,401
現金及び現金同等物の期首残高	27,244	32,646
現金及び現金同等物の期末残高	35,310	27,244

注)前第1四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を開示していないため、表示しておりません。

グループ最大の開発拠点「ホワイトキャンパス洛西」がオープン



「ホワイトキャンパス洛西」の外観

当社は、グループの開発体制の強化を目指し、約8億円の総工費を掛けて、技術開発機能を集結した拠点「ホワイトキャンパス洛西」を開設し、2006年4月より業務を開始しました。「ひらめいたアイデアを自由に描き、新たな技術や産業を創造したい」という願いを込めて「ホワイトキャンパス洛西」と名付けられた当施設は、各地に点在していた技術開発の拠点を洛西事業所に集約して開発資源を統合するとともに、技術者の開発環境を一新し、技術経営を一層強化し、お客さまのニーズを先取りする技術開発の実現を目的としています。

Concentration (集結・集中・集う)、Conversation (会話・交渉・社交)、Collaboration (協力・共同・提携)の『3Cコンセプト』を掲げ、延べ床面積約2万平方メートルに及ぶ施設には、クリーンルームを備えた実験研究棟のほか、200人を収容で



玄関ロビーにある経営理念「思考展開」のモニュメント



間仕切りのないオフィスエリア



スクリーングループの技術開発の歩みなどが展示されている空間SOPHIA(ソフィア)

(株)クォーツリード、品質・環境・安全の マネジメントシステムを統合化

きる大ホールClair(クレール)、打ち合わせ・待ち合わせの空間としてSOPHIA(Screen Open High-tech Area、ソフィア)、仕切りのないオープンな環境のオフィスエリアなどが配置されています。

当社は、これらの施設を活用し、社内技術者同士のみならず、他の企業や研究機関などとの技術交流を促進し、技術の融合を図り新たな技術・事業の創造を目指していきます。

また、「ホワイトキャンバス洛西」の業務開始と同時に、従来の技術開発センターは技術開発カンパニーに組織変更しました。これは、技術開発体制を効率化、強化するとともに、技術者に社内カンパニーの一員としての意識改革を促すことも目的としています。

当社は当施設の開設による技術拠点の集約と組織改革によ



大ホールClair(クレール)

り、既存事業の深耕を図るほか、経営理念である「思考展開」を実践し、次世代をけん引する新技術の開発に積極的に取り組んでいきます。

当社が100%出資する子会社、(株)クォーツリード(本社:福島県郡山市)は、福島県内で初となるマネジメントシステムの統合化を、国内全拠点を対象に実現し、2006年5月から運用を開始しました。

(株)クォーツリードでは、2002年に品質マネジメントシステム「ISO9001」、2003年に環境マネジメントシステム「ISO14001」の認証を取得し、順次システムを導入してきました。今回、労働安全衛生マネジメントシステム「OHSAS18001」の認証を取得するに当たり、それぞれのシステムを集約し、統合マネジメントシステムとして一本化しました。文書管理、実行計画、内部監査などの各システムの共通要素を一元管理することにより、運用精度の向上と社内情報共有の効率化、さらにシステムの維持コスト軽減を図っています。

(株)クォーツリードは、今回のマネジメントシステムの統合化により、「経営」「財務」「労働安全衛生」「品質」「環境」など、多角的な側面から自社の分析を行い、企業の社会的責任(CSR)を果たしていきます。

自己株式の取得に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、2006年8月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、同日以下の内容を発表いたしました。

1. 自己株式の取得を行う理由

1株当たりの株主価値の向上を図るため。

2. 取得の内容

(1) 取得する株式の種類	当社普通株式
(2) 取得する株式の総数	600万株(上限) (発行済株式総数に対する割合 2.36%)
(3) 株式の取得価額の総額	50億円(上限)
(4) 自己株式取得の日程	2006年8月11日から 2006年9月22日まで

「ノムラ・アジア・エクイティ・フォーラム
2006」でプレゼンテーションを行う
橋本社長



アジアおよび米国でIR(投資家向け広報)活動を実施

当社は2006年7月上旬、アジアと米国で、IR(投資家向け広報)活動を行いました。

アジアでは、7月11日と12日に香港で機関投資家とのミーティングを実施した後、シンガポールで7月11日から14日にわたり開催された、野村証券(株)による「ノムラ・アジア・エクイティ・フォーラム(NAEF) 2006」に参加しました。当フォーラムは機関投資家を対象として開かれ、シンガポール、香港、日本などから延べ1,055名の機関投資家が出席し、日本の上場企業約50社、アジアの企業約60社が参加しました。当社は7月13日と14日の2日間参加し、橋本社長によるプレゼンテーションおよび投資家との個別ミーティングを実施しました。

また、米国では、2006年7月10日から14日にわたりサンフランシスコで開催された、北米最大の半導体関係のイベント「SEMICON WEST(セミコン・ウエスト) 2006」の機会を活用し、米国の機関投資家とのグループミーティングを実施しました。また、会場においては半導体関連の証券アナリストおよび機関投資家に対し、当社の展示ブースツアーを行いました。

今回の活動は、国内、欧州以外で初めて実施する本格的なIR活動となりました。当社は今後も、国内に加えて海外におけるIR活動にも積極的に取り組み、当社の経営理念や事業活動に対する理解促進に努め、企業価値の向上を図っていきます。

皆さまに身近な商品の中で、当社の技術や製品が活躍している例をご紹介します。

携帯型音楽プレーヤー「iPod」に採用された「ヒラギノ書体」

当社が開発、販売しているデジタルフォント「ヒラギノ書体」が、Apple（アップル）社の携帯型音楽プレーヤー「iPod」（ハードディスクタイプ）の表示フォントに採用されています。

京都の地名である「柘野」にちなんで名付けられた「ヒラギノ書体」は、1993年の開発以来、プロのデザイナーに高く評価され、雑誌や出版物、テレビ番組のテロップやコマーシャルなどあらゆる場面で活用されてきました。

特に、「美しい書体デザインと洗練された品位を兼ね備えていること」「デザインの一貫性を備えた明朝体やゴシック体がそろっていること」「出版や商業印刷に使用できる高い品質」が評価され、2001年よりApple社のMacintosh（マッキントッシュ）パソコンに6書体が標準搭載されたことで、一般のMacintoshユーザーも手軽に利用できるようになりました。これらの実績が認められ、同社の「iPod」への採用につながりました。

昨年、「ヒラギノ書体」は（財）日本産業デザイン振興会主催の「2005年度グッドデザイン賞」を受賞しています。当社は今後、プロのデザイナーへの認知・浸透をさらに高めていくほか、携帯型音楽プレーヤーや携帯電話のような一般製品への採用も目指して、積極的に事業を展開していきます。



■ アニュアルレポート2006と インベスターズガイド2006を発行

2006年3月期のアニュアルレポートを発行しました。アニュアルレポートは英文の年次報告書で、経営者のメッセージや営業活動報告、財務諸表などを掲載しています。当社では日本語訳版も併せて制作しています。また、当社の財務データを中心にまとめたインベスターズガイドも同時に発行しています。

これらをご希望の方は、同封のアンケートはがきに、株主番号、郵便番号、住所、氏名をご記入の上、「IR資料希望」と明記いただき、お申し込みください。

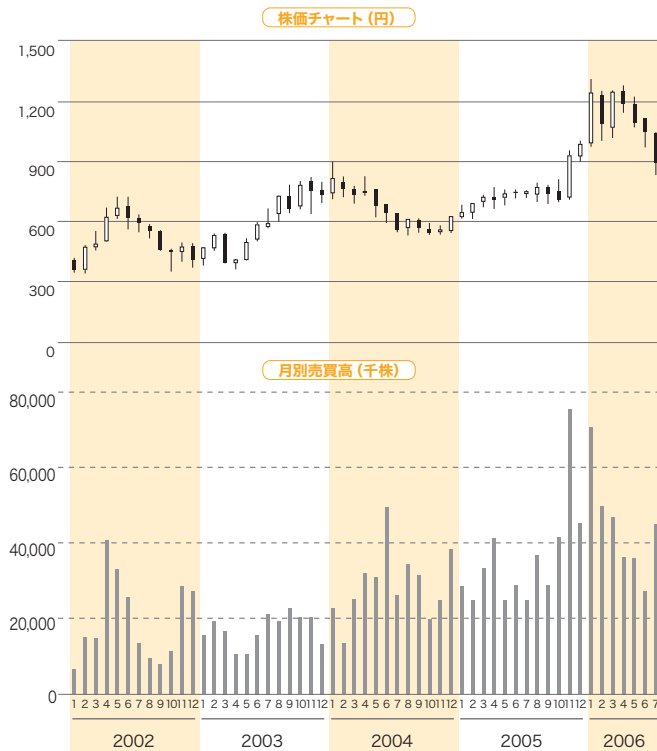


アニュアルレポート2006



インベスターズガイド2006

■ 株価および出来高の推移



SCREEN

「SCREEN NOW」(株主通信)は、当社のフォント「ヒラギノ書体」を使用し、デジタル印刷機「Truepress」で印刷しております。
また、表紙写真は、グループ会社マイザ(株)の「マイサイメーヅライブラリー」の素材を使用しております。表紙写真(左):北野天満宮(撮影協力 京都府神社庁)

SCREEN NOW No.60 発行日:2006年9月28日(発行は3月、6月、9月、12月)
発行:大日本スクリーン製造株式会社IR室 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 電話075(414)7111
ホームページアドレス:<http://www.screen.co.jp/> 証券コード7735



本誌は、再生紙を使用しています。
IR-SN-60